

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 3 区分
【発行日】平成 18 年 3 月 16 日 (2006.3.16)

【公開番号】特開 2005-262363 (P2005-262363A)
【公開日】平成 17 年 9 月 29 日 (2005.9.29)
【年通号数】公開・登録公報 2005-038
【出願番号】特願 2004-77299 (P2004-77299)
【国際特許分類】

B 2 4 B 1/00 (2006.01)

【F I】

B 2 4 B 1/00 Z

【手続補正書】
【提出日】平成 18 年 1 月 31 日 (2006.1.31)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 3 8
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 3 8】

図 7 に、実施例 1 により研削した炭化けい素ファインセラミックの工作物の表面の光干渉式高精度表面測定器 (WYKO) による二次元粗さ測定による X、Y プロファイルを示す。図 7 よりわかるように、実際に得られた研削方向平行仕上面粗さは、P - V 値で 14nm (図 7 では、R t 値)、R a 値で 3nm 以下であり、一方、研削方向直角仕上面粗さは、P - V 値で約 23nm、R a 値で約 4nm となっており、高能率に超平滑研削加工が行えたことが分かる。